

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2023-008

山东天岳先进科技股份有限公司

关于公司 2023 年度申请授信及提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

1、山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）为满足生产经营和发展需要，拟向银行等金融机构申请不超过人民币 200,000.00 万元的授信额度，同时，公司拟为全资子公司上海越服科贸有限公司（以下简称“上海越服”）、上海天岳半导体材料有限公司（以下简称“上海天岳”）提供预计合计不超过 70,000.00 万元的担保额度，最终授信金额及担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

2、被担保人：上海越服科贸有限公司、上海天岳半导体材料有限公司

3、截至董事会召开日，公司及子公司对外担保总额为 0 元，公司对子公司已实际发生的担保余额为 0 元。

4、被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。

5、本次申请授信及提供担保事项无需股东大会审议。

现将具体情况公告如下：

一、2023 年度申请授信及提供担保情况

为满足生产经营和发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 200,000.00 万元的授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、中长期贷款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等，具体授信业务品种、额度和期限以金融机构最终批复为准，上述授信额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。以上授信额度不等于公司的实际授信金额，实际授信金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。公司将根据金融机构的要求以自有资产为公司自身授信提供抵押或质押担

保,各子公司将根据金融机构的要求以自有资产为各子公司自身授信提供抵押或质押担保。

同时,为满足生产经营和发展需要,提高公司决策效率,公司拟为全资子公司上海越服及上海天岳提供预计合计不超过 70,000.00 万元的担保额度,担保方式包括保证、抵押、质押等,具体担保期限根据届时签订的担保合同为准,上述担保额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。担保额度可以在上海越服及上海天岳之间进行调剂。

公司提请董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要,在上述授信额度及担保额度范围内,全权办理公司向金融机构获取授信额度及提供担保相关的具体事项。

二、被担保人的基本情况

(一) 上海越服基本情况

1、名称：上海越服科贸有限公司

2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、注册地址：上海市嘉定区菊园新区环城路 2222 号 1 幢 J4526 室

4、法定代表人：钟文庆

5、注册资本：1,000 万元

6、成立日期：2019 年 12 月 6 日

7、经营范围：一般项目：仪器仪表、机电设备、五金交电、通讯器材、日用百货、办公用品、工艺品（象牙及其制品除外）、计算机、软件及辅助设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、耐火材料、保温材料、电子元器件、半导体、电子产品的销售，家用电器销售。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8、股权结构：上海越服为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

9、主要财务数据：

单位：万元；币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
----	------------------	-----------------

	(经审计)	(未经审计)
资产总额	4,865.78	4,746.00
负债总额	3,224.67	2,813.62
净资产	1,641.10	1,932.37
项目	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	35,104.64	23,628.08
净利润	513.67	291.27

(二) 上海天岳基本情况

- 1、名称：上海天岳半导体材料有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区鸿音路 1211 号 10 幢 301 室
- 4、法定代表人：宗艳民
- 5、注册资本：6,000 万元
- 6、成立日期：2020 年 6 月 2 日
- 7、经营范围：一般项目：电子专用材料研发、电子专用材料制造，电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；半导体器件专用设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体分立器件制造；合成材料制造（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；半导体分立器件销售；电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；电子元器件批发；电子元器件零售；合成材料销售；光电子器件制造；光电子器件销售，电子专用材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
- 8、股权结构：上海天岳为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。
- 9、主要财务数据：

单位：万元；币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	36,717.34	97,636.32
负债总额	32,127.83	60,715.75

净资产	4,589.51	36,920.57
项目	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	-	83.71
净利润	-1,055.56	-1,668.95

上海越服、上海天岳 2021 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。上海越服、上海天岳无影响偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述申请授信及担保金额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信金额、担保金额、担保期限等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为确保公司生产经营持续稳健发展，并结合目前公司业务情况进行进行的预计，有助于满足公司日常资金使用需求，符合公司整体生产经营的实际需要，担保对象均为公司全资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：本次公司及合并报表范围内子公司申请不超过人民币 200,000.00 万元的授信额度，同时，公司为全资子公司上海越服科贸有限公司（以下简称“上海越服”）、上海天岳半导体材料有限公司（以下简称“上海天岳”）提供预计合计不超过 70,000.00 万元的担保额度，是为了满足公司生产经营和业务发展需要，公司对相关风险能够有效控制，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关制度规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。综上，监事会同意本次公司

及合并报表范围内子公司向银行申请综合授信额度及公司为上海越服、上海天岳提供担保事项。

（二）独立董事意见

1、公司及合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请不超过人民币200,000.00万元授信额度及公司为全资子公司上海越服科贸有限公司、上海天岳半导体材料有限公司提供预计合计不超过70,000.00万元的担保额度事项是为满足公司及全资子公司经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司，公司对相关风险能够有效控制，决策和审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、我们一致同意上述申请授信及提供担保事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，本次申请授信及提供担保事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》及公司对外担保管理制度等相关规定；本次申请授信及提供担保基于公司经营管理需要而进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司2023年度申请授信及提供担保事项无异议。

六、累计对外担保总额及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为0元，无逾期担保或涉及担保诉讼情形。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2023年2月28日